

Flip chip Bonder

FB1000SS Flip chip bonder

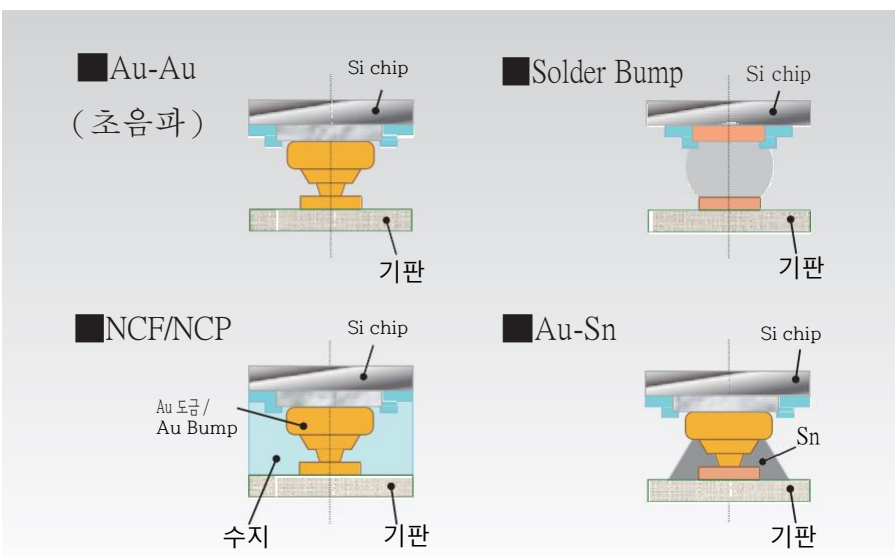
반도체의 고정밀 실장에 최적의 Flip chip Bonder



헤드 하중	하중 50 ~ 1000N
헤드 종류	초음파헤드 (Heater head · Mount head로 교환 가능)
초음파 주파수	주파수 : 30 k Hz/40 k Hz/50 k Hz 선택
헤드 제어	하중, 위치, 초음파의 디지털 제어
얼라이먼트 정밀도	±5 μm
유효 워크 범위	□200mm
접합 모니터링	프로파일 참조 소프트웨어 표준 탑재
조건설정	접합조건 : 디지털 설정
유틸리티	공압원 0.5MPa Dry Air
	전원 본체 200V50A
장비 사이즈	W1190 x D1090 x H1650mm (본체부)
장비 중량	800kg

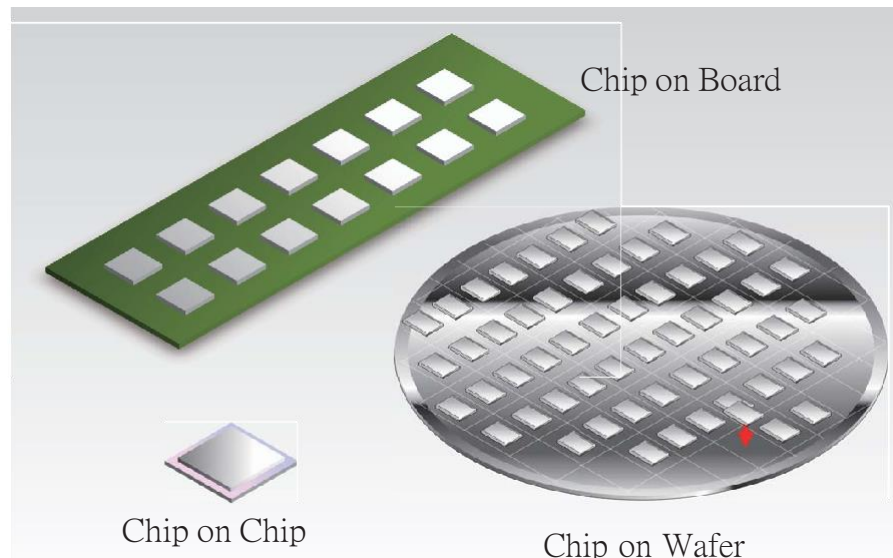
어플리케이션

● 접합 프로세스 사례



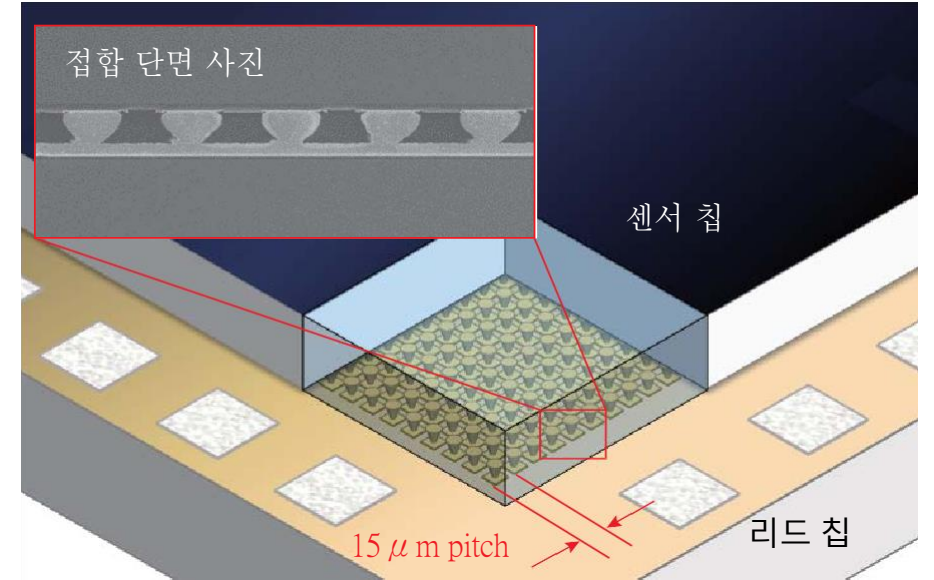
각종 접합 프로세스 대응

● 실장 형태 사례



사용자 요구에 맞춘 커스터마이징

● 15 μm pitch 30 만 범프 실장 사례



15μm pitch 디바이스를 초음파 접합

고강성 혼 클램프 구조

【리지드 클램프】에 의한 초음파혼을 직접 클램핑. 고강성 클램프로 고하중에도 높은 평탄도를 확보.



고강성
특허 등록

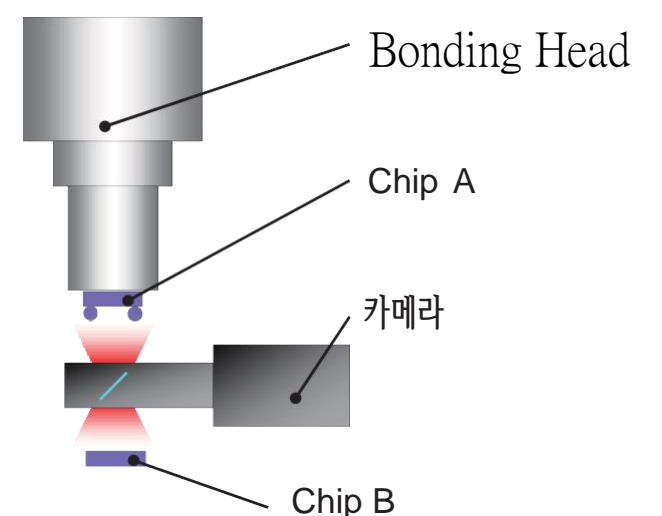
컴팩트한 사이즈

고정밀 얼라이먼트

상하 2 시야 인식과 시간의 경과에 따른 변화를 보정하는 [정렬 보정 기능]을 탑재. 안정적인 고정밀 구현을 실현.

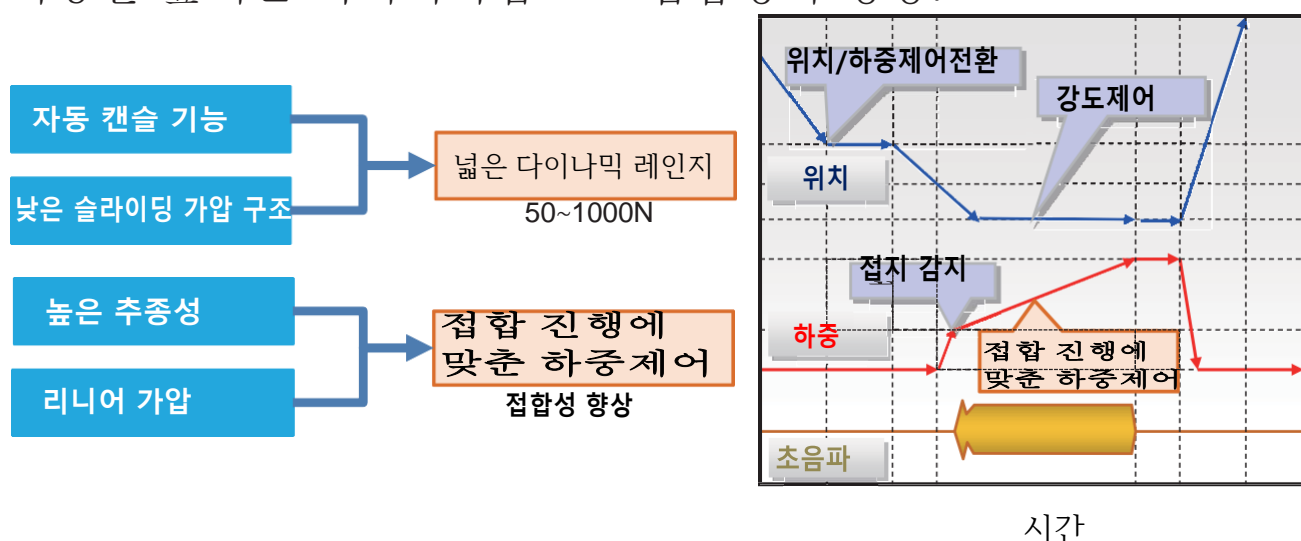
상 하 2시야 인식

Calibration 기능



고기능 위치 하중 제어

낮은 슬라이딩 가압기구에 의한 넓은 다이내믹 레인지를 실현. 접합시 변형에 대한 높은 추종성을 갖고, 접합 진행과 함께 하중을 높이는 리니어가압으로 접합성이 향상.



자동 캔슬 기능

낮은 슬라이딩 가압 구조

높은 추종성

리니어 가압

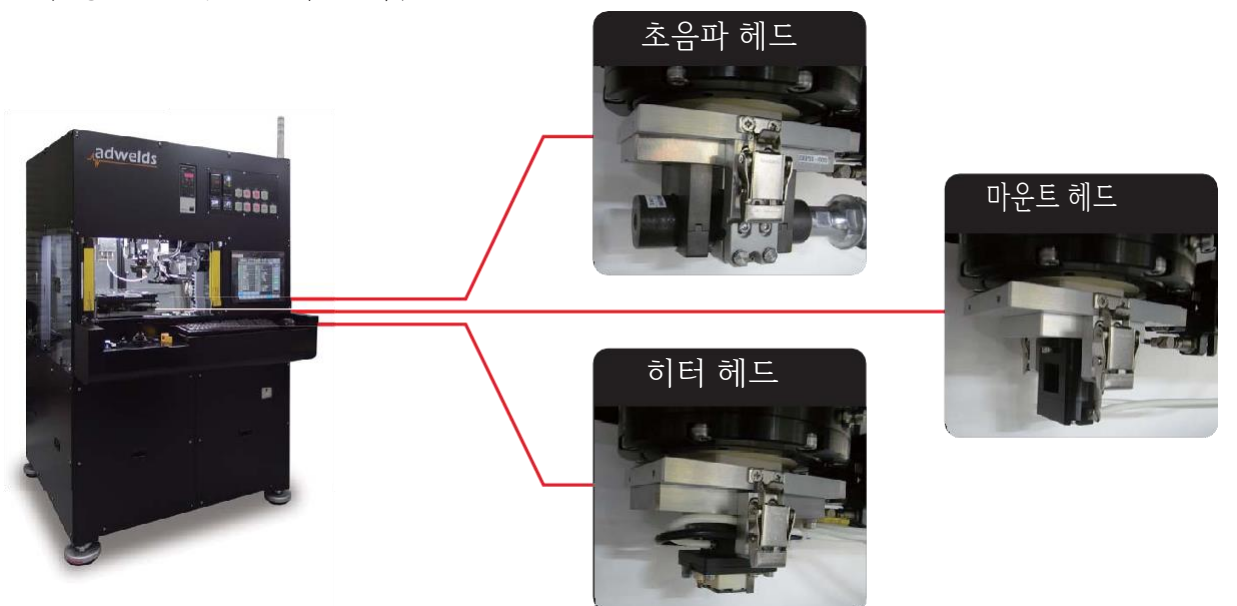
넓은 다이내믹 레인지
50~1000N

접합 진행에
맞춘 하중 제어
접합성 향상

시간

Head교환으로 각종 프로세스 대응

접합 프로세스에 맞추어 쉽게 헤드 교체가 가능. 고객의 요구에 맞춘 다양한 헤드 라인업.



株式会社アドウィズ
福岡 本社
東京営業所
名古屋テクニカルセンター

<http://www.adwelds.com> Mail info@adwelds.com
〒811-1201 福岡県那珂川市片縄 8 丁目 140 番地
〒140-0004 東京都品川区南品川 5 丁目 10 番 45 号
〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂 4 丁目 206 番地

TEL 092-555-6000
TEL 03-6433-9920

なごやサイエンスパーク 先端技術連携リサーチセンター内